

电子组件拆焊高阶检修技术竞赛

竞赛规则

DATE: 202503

壹、参赛资格:

- 一、高、中职选手不分组别，依选择竞赛级别分组（专业级、专家级）。
- 二、每队需由 1~2 位指导老师及参赛同学 1 名组成。指导老师可同时指导多组队伍，参赛同学仅能报名一队，违者将判定丧失资格。

貳、竞赛说明:

一、竞赛方式:

参赛者可自行选择报名一项竞赛级别，不可同时报名专业及专家级。

1. **专业级**: 依电子组件拆焊专业级能力认证正式认证内容实施，需搭配竞赛时间，依大会规定之时间内认定奖项名次，竞赛内容请参考【电子组件拆焊专业级术科测验参考数据】。
2. **专家级**: 依电子组件拆焊专家级能力认证正式认证内容实施，需搭配竞赛时间，依大会规定之时间内认定奖项名次，竞赛内容请参考【电子组件拆焊专家级术科测验参考数据】。

二、评分标准

1. 评分标准依电子组件拆焊专业级/专家级认证内容实施。
2. 电子组件拆焊专业级/专家级竞赛评分接分为两部份:

评分阶段	专业级	专家级
第一阶段	(1)拆焊电路板(SCBL): 全数组件拆卸完成 (2)EM78P451SAQ IC 芯片: 需在拆焊测试板完成功能测试 (3)评审注记完成	
第二阶段	(1)完成拆焊电路板(SCBL), 并测试功能正常 (2)评审评分	(1)完成焊接拆焊电路板(SCBL)及 圆孔电路板(SCBH), 并测试功能正常 (2)评审评分

3. 测试板功能测试操作需由参赛人员自行操作，不得要求评审或旁人协助，违者取消资格。
4. 提出评分后，参赛者不得再进行调整或维修动作。
5. 参赛者提出组合功能测试评分要求之时间，由评审于评分表中填写勾选完工时间，即为此次术科竞赛总花费时数。

参、竞赛流程

一、竞赛时间：

时间	时数	说明
08:30~09:45	15 分钟	报到
08:45~09:00	15 分钟	宣布规则、抽签、拆焊成品板及测试板检验
09:00~11:30 (参赛者需待评分完成后才可离场)	150 分钟	1. 10 分钟内拆焊板功能有瑕疵或异状 (要求更换不扣分) 2. 30 分钟内材料包缺件(补零件不扣分, 仅限周边圆孔板 SCBH 材料包) 3. 竞赛流程: 队伍进行拆焊作业, 完成后举手进行评分。